

本資料由 (上櫃公司) 協易機械 公司提供

序號 1 發言日期 100/12/14 發言時間 18:36:09
發言人 魏淵欽 發言人職稱 營業處副總 發言人電話 (03)3525466

主旨 更正依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第三款及第四款之公告

符合條款 第二條 第 22 款 事實發生日 100/12/14

1. 事實發生日:100/12/14
2. 被背書保證之:
 - (1) 公司名稱:SEYI TECHNOLOGY (SAMOA) INC.
 - (2) 與提供背書保證公司之關係:
提供背書保證公司為被背書保證公司之直接或間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司
 - (3) 背書保證之限額(仟元):516549
 - (4) 原背書保證之餘額(仟元):0
 - (5) 本次新增背書保證之金額(仟元):216684
 - (6) 迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):216684
 - (7) 被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
 - (8) 本次新增背書保證之原因:
對被背書保證公司銀行借款背書擔保
3. 被背書保證公司提供擔保品之:

說明 (1) 內容:
無

- (2) 價值(仟元):0
4. 被背書保證公司最近期財務報表之:
 - (1) 資本(仟元):392455
 - (2) 累積盈虧金額(仟元):683070
5. 解除背書保證責任之:
 - (1) 條件:
銀行借款到期償還本金
 - (2) 日期:
銀行借款到期償還日
6. 背書保證之總限額(仟元):
826478
7. 迄事實發生日為止, 背書保證餘額(仟元):
408680

8. 迄事實發生日為止，A 提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率：

19.78

9. 迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率：

81.05

10. 其他應敘明事項：

無